

# 2023-2029年中国芯片市场 深度评估与未来前景预测报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2023-2029年中国芯片市场深度评估与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202304/352689.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国芯片市场深度评估与未来前景预测报告》共十三章。首先介绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章&nbsp;芯片行业的总体概述

#### 1.1&nbsp;基本概念

#### 1.2&nbsp;制作过程

##### 1.2.1&nbsp;原料晶圆

##### 1.2.2&nbsp;晶圆涂膜

##### 1.2.3&nbsp;光刻显影

##### 1.2.4&nbsp;掺杂杂质

##### 1.2.5&nbsp;晶圆测试

##### 1.2.6&nbsp;芯片封装

##### 1.2.7&nbsp;测试包装

### 第二章&nbsp;2019-2022年全球芯片产业发展分析

#### 2.1&nbsp;2019-2022年世界芯片市场综述

##### 2.1.1&nbsp;市场特点分析

##### 2.1.2&nbsp;全球发展形势

##### 2.1.3&nbsp;全球市场规模

##### 2.1.4&nbsp;市场竞争格局

#### 2.2&nbsp;美国

##### 2.2.1&nbsp;全球市场布局

- 2.2.2&emsp;行业并购热潮
- 2.2.3&emsp;行业从业人数
- 2.2.4&emsp;类脑芯片发展
- 2.3&emsp;日本
  - 2.3.1&emsp;产业订单规模
  - 2.3.2&emsp;技术研发进展
  - 2.3.3&emsp;芯片工厂布局
  - 2.3.4&emsp;日本产业模式
  - 2.3.5&emsp;产业战略转型
- 2.4&emsp;韩国
  - 2.4.1&emsp;产业发展阶段
  - 2.4.2&emsp;技术发展历程
  - 2.4.3&emsp;外贸市场规模
  - 2.4.4&emsp;产业创新模式
  - 2.4.5&emsp;市场发展策略
- 2.5&emsp;印度
  - 2.5.1&emsp;芯片设计发展形势
  - 2.5.2&emsp;政府扶持产业发展
  - 2.5.3&emsp;产业发展对策分析
  - 2.5.4&emsp;未来发展机遇分析
- 2.6&emsp;其他国家芯片产业发展分析
  - 2.6.1&emsp;英国
  - 2.6.2&emsp;德国
  - 2.6.3&emsp;瑞士

### 第三章&emsp;中国芯片产业发展环境分析

- 3.1&emsp;政策环境
  - 3.1.1&emsp;智能制造政策
  - 3.1.2&emsp;集成电路政策
  - 3.1.3&emsp;半导体产业规划
  - 3.1.4&emsp;“互联网+”政策
- 3.2&emsp;经济环境

3.2.1&emsp;国民经济运行状况

3.2.2&emsp;工业经济增长情况

3.2.3&emsp;固定资产投资情况

3.2.4&emsp;经济转型升级形势

3.2.5&emsp;宏观经济发展趋势

3.3&emsp;社会环境

3.3.1&emsp;互联网加速发展

3.3.2&emsp;智能产品的普及

3.3.3&emsp;科技人才队伍壮大

3.4&emsp;技术环境

3.4.1&emsp;技术研发进展

3.4.2&emsp;无线芯片技术

3.4.3&emsp;技术发展趋势

#### 第四章&emsp;2019-2022年中国芯片产业发展分析

4.1&emsp;中国芯片行业发展综述

4.1.1&emsp;产业发展历程

4.1.2&emsp;全球发展地位

4.1.3&emsp;海外投资标的

4.2&emsp;2019-2022年中国芯片市场格局分析

4.2.1&emsp;市场规模现状

4.2.2&emsp;市场竞争格局

4.2.3&emsp;行业利润流向

4.2.4&emsp;市场发展动态

4.3&emsp;2019-2022年中国量子芯片发展进程

4.3.1&emsp;产品发展历程

4.3.2&emsp;市场发展形势

4.3.3&emsp;产品研发动态

4.3.4&emsp;未来发展前景

4.4&emsp;2019-2022年芯片产业区域发展动态

4.4.1&emsp;湖南

4.4.2&emsp;贵州

4.4.3&emsp;北京

4.4.4&emsp;晋江

4.5&emsp;中国芯片产业发展问题分析

4.5.1&emsp;产业发展困境

4.5.2&emsp;开发速度放缓

4.5.3&emsp;市场垄断困境

4.6&emsp;中国芯片产业应对策略分析

4.6.1&emsp;企业发展战略

4.6.2&emsp;突破垄断策略

4.6.3&emsp;加强技术研发

第五章&emsp;2019-2022年中国芯片产业上游市场发展分析

5.1&emsp;2019-2022年中国半导体产业发展分析

5.1.1&emsp;行业发展意义

5.1.2&emsp;产业政策环境

5.1.3&emsp;市场规模现状

5.1.4&emsp;产业资金投资

5.1.5&emsp;市场前景分析

5.1.6&emsp;未来发展方向

5.2&emsp;2019-2022年中国芯片设计行业发展分析

5.2.1&emsp;产业发展历程

5.2.2&emsp;市场发展现状

5.2.3&emsp;市场竞争格局

5.2.4&emsp;企业专利情况

5.2.5&emsp;国内外差距分析

5.3&emsp;2019-2022年中国晶圆代工产业发展分析

5.3.1&emsp;晶圆加工技术

5.3.2&emsp;国外发展模式

5.3.3&emsp;国内发展模式

5.3.4&emsp;企业竞争现状

5.3.5&emsp;市场布局分析

5.3.6&emsp;产业面临挑战

## 第六章&nbsp;芯片设计行业重点企业经营分析

### 6.1&nbsp;高通公司

#### 6.1.1&nbsp;企业发展概况

#### 6.1.2&nbsp;经营效益分析

#### 6.1.3&nbsp;新品研发进展

#### 6.1.4&nbsp;产品应用情况

#### 6.1.5&nbsp;未来发展前景

### 6.2&nbsp;博通有限公司（原安华高科技）

#### 6.2.1&nbsp;企业发展概况

#### 6.2.2&nbsp;经营效益分析

#### 6.2.3&nbsp;新品研发进展

#### 6.2.4&nbsp;产品应用情况

#### 6.2.5&nbsp;未来发展前景

### 6.3&nbsp;英伟达

#### 6.3.1&nbsp;企业发展概况

#### 6.3.2&nbsp;经营效益分析

#### 6.3.3&nbsp;新品研发进展

#### 6.3.4&nbsp;产品应用情况

#### 6.3.5&nbsp;未来发展前景

### 6.4&nbsp;AMD

#### 6.4.1&nbsp;企业发展概况

#### 6.4.2&nbsp;经营效益分析

#### 6.4.3&nbsp;新品研发进展

#### 6.4.4&nbsp;产品应用情况

#### 6.4.5&nbsp;未来发展前景

### 6.5&nbsp;Marvell

#### 6.5.1&nbsp;企业发展概况

#### 6.5.2&nbsp;经营效益分析

#### 6.5.3&nbsp;新品研发进展

#### 6.5.4&nbsp;产品应用情况

#### 6.5.5&nbsp;未来发展前景

## 6.6&emsp;赛灵思

### 6.6.1&emsp;企业发展概况

### 6.6.2&emsp;经营效益分析

### 6.6.3&emsp;新品研发进展

### 6.6.4&emsp;产品应用情况

### 6.6.5&emsp;未来发展前景

## 6.7&emsp;Altera

### 6.7.1&emsp;企业发展概况

### 6.7.2&emsp;经营效益分析

### 6.7.3&emsp;新品研发进展

### 6.7.4&emsp;产品应用情况

### 6.7.5&emsp;未来发展前景

## 6.8&emsp;Cirruslogic

### 6.8.1&emsp;企业发展概况

### 6.8.2&emsp;经营效益分析

### 6.8.3&emsp;新品研发进展

### 6.8.4&emsp;产品应用情况

### 6.8.5&emsp;未来发展前景

## 6.9&emsp;联发科

### 6.9.1&emsp;企业发展概况

### 6.9.2&emsp;经营效益分析

### 6.9.3&emsp;新品研发进展

### 6.9.4&emsp;产品应用情况

### 6.9.5&emsp;未来发展前景

## 6.10&emsp;展讯

### 6.10.1&emsp;企业发展概况

### 6.10.2&emsp;经营效益分析

### 6.10.3&emsp;新品研发进展

### 6.10.4&emsp;产品应用情况

### 6.10.5&emsp;未来发展前景

## 6.11&emsp;其他企业

### 6.11.1&emsp;海思



6.11.2&emsp;瑞星

6.11.3&emsp;Dialog

## 第七章&emsp;晶圆代工行业重点企业经营分析

7.1&emsp;格罗方德

7.1.1&emsp;企业发展概况

7.1.2&emsp;经营效益分析

7.1.3&emsp;企业发展形势

7.1.4&emsp;产品发展方向

7.1.5&emsp;未来发展前景

7.2&emsp;三星

7.2.1&emsp;企业发展概况

7.2.2&emsp;经营效益分析

7.2.3&emsp;企业发展形势

7.2.4&emsp;产品发展方向

7.2.5&emsp;未来发展前景

7.3&emsp;Towerjazz

7.3.1&emsp;企业发展概况

7.3.2&emsp;经营效益分析

7.3.3&emsp;企业发展形势

7.3.4&emsp;产品发展方向

7.3.5&emsp;未来发展前景

7.4&emsp;富士通

7.4.1&emsp;企业发展概况

7.4.2&emsp;经营效益分析

7.4.3&emsp;企业发展形势

7.4.4&emsp;产品发展方向

7.4.5&emsp;未来发展前景

7.5&emsp;台积电

7.5.1&emsp;企业发展概况

7.5.2&emsp;经营效益分析

7.5.3&emsp;企业发展形势

7.5.4&emsp;产品发展方向

7.5.5&emsp;未来发展前景

7.6&emsp;联电

7.6.1&emsp;企业发展概况

7.6.2&emsp;经营效益分析

7.6.3&emsp;企业发展形势

7.6.4&emsp;产品发展方向

7.6.5&emsp;未来发展前景

7.7&emsp;力晶

7.7.1&emsp;企业发展概况

7.7.2&emsp;经营效益分析

7.7.3&emsp;企业发展形势

7.7.4&emsp;产品发展方向

7.7.5&emsp;未来发展前景

7.8&emsp;中芯

7.8.1&emsp;企业发展概况

7.8.2&emsp;经营效益分析

7.8.3&emsp;企业发展形势

7.8.4&emsp;产品发展方向

7.8.5&emsp;未来发展前景

7.9&emsp;华虹

7.9.1&emsp;企业发展概况

7.9.2&emsp;经营效益分析

7.9.3&emsp;企业发展形势

7.9.4&emsp;产品发展方向

7.9.5&emsp;未来发展前景

## 第八章&emsp;2019-2022年中国芯片产业中游市场发展分析

8.1&emsp;2019-2022年中国芯片封装行业发展分析

8.1.1&emsp;封装技术介绍

8.1.2&emsp;市场发展现状

8.1.3&emsp;国内竞争格局

- 8.1.4&emsp;技术发展趋势
- 8.2&emsp;2019-2022年中国芯片测试行业发展分析
  - 8.2.1&emsp;IC测试原理
  - 8.2.2&emsp;测试准备规划
  - 8.2.3&emsp;主要测试分类
  - 8.2.4&emsp;发展面临的问题
- 8.3&emsp;中国芯片封测行业发展方向分析
  - 8.3.1&emsp;承接产业链转移
  - 8.3.2&emsp;集中度持续提升
  - 8.3.3&emsp;国产化进程加快
  - 8.3.4&emsp;产业短板补齐升级
  - 8.3.5&emsp;加速淘汰落后产能

## 第九章&emsp;芯片封装测试行业重点企业经营分析

- 9.1&emsp;Amkor
  - 9.1.1&emsp;企业发展概况
  - 9.1.2&emsp;经营效益分析
  - 9.1.3&emsp;业务经营分析
  - 9.1.4&emsp;财务状况分析
  - 9.1.5&emsp;未来前景展望
- 9.2&emsp;日月光
  - 9.2.1&emsp;企业发展概况
  - 9.2.2&emsp;经营效益分析
  - 9.2.3&emsp;业务经营分析
  - 9.2.4&emsp;财务状况分析
  - 9.2.5&emsp;未来前景展望
- 9.3&emsp;矽品
  - 9.3.1&emsp;企业发展概况
  - 9.3.2&emsp;经营效益分析
  - 9.3.3&emsp;业务经营分析
  - 9.3.4&emsp;财务状况分析
  - 9.3.5&emsp;未来前景展望

#### 9.4&emsp;南茂

9.4.1&emsp;企业发展概况

9.4.2&emsp;经营效益分析

9.4.3&emsp;业务经营分析

9.4.4&emsp;财务状况分析

9.4.5&emsp;未来前景展望

#### 9.5&emsp;颀邦

9.5.1&emsp;企业发展概况

9.5.2&emsp;经营效益分析

9.5.3&emsp;业务经营分析

9.5.4&emsp;财务状况分析

9.5.5&emsp;未来前景展望

#### 9.6&emsp;长电科技

9.6.1&emsp;企业发展概况

9.6.2&emsp;经营效益分析

9.6.3&emsp;业务经营分析

9.6.4&emsp;财务状况分析

9.6.5&emsp;未来前景展望

#### 9.7&emsp;天水华天

9.7.1&emsp;企业发展概况

9.7.2&emsp;经营效益分析

9.7.3&emsp;业务经营分析

9.7.4&emsp;财务状况分析

9.7.5&emsp;未来前景展望

#### 9.8&emsp;通富微电

9.8.1&emsp;企业发展概况

9.8.2&emsp;经营效益分析

9.8.3&emsp;业务经营分析

9.8.4&emsp;财务状况分析

9.8.5&emsp;未来前景展望

#### 9.9&emsp;士兰微

9.9.1&emsp;企业发展概况

9.9.2&emsp;经营效益分析

9.9.3&emsp;业务经营分析

9.9.4&emsp;财务状况分析

9.9.5&emsp;未来前景展望

9.10&emsp;其他企业

9.10.1&emsp;UTAC

9.10.2&emsp;J-Device

## 第十章&emsp;2019-2022年中国芯片产业下游应用市场发展分析

10.1&emsp;LED

10.1.1&emsp;全球市场规模

10.1.2&emsp;LED芯片厂商

10.1.3&emsp;主要企业布局

10.1.4&emsp;封装技术难点

10.1.5&emsp;LED产业趋势

10.2&emsp;物联网

10.2.1&emsp;产业链的地位

10.2.2&emsp;市场发展现状

10.2.3&emsp;物联网wifi芯片

10.2.4&emsp;国产化的困境

10.2.5&emsp;产业发展困境

10.3&emsp;无人机

10.3.1&emsp;全球市场规模

10.3.2&emsp;市场竞争格局

10.3.3&emsp;主流主控芯片

10.3.4&emsp;芯片重点应用领域

10.3.5&emsp;市场前景分析

10.4&emsp;北斗系统

10.4.1&emsp;北斗芯片概述

10.4.2&emsp;产业发展形势

10.4.3&emsp;芯片生产现状

10.4.4&emsp;芯片研发进展

10.4.5&emsp;资本助力发展

10.4.6&emsp;产业发展前景

10.5&emsp;智能穿戴

10.6&emsp;智能手机

10.7&emsp;汽车电子

10.8&emsp;生物医药

## 第十一章&emsp;2019-2022年中国集成电路产业发展分析

11.1&emsp;中国集成电路行业总况分析

11.1.1&emsp;国内市场崛起

11.1.2&emsp;产业政策推动

11.1.3&emsp;主要应用市场

11.1.4&emsp;产业增长形势

11.2&emsp;2019-2022年集成电路市场规模分析

11.2.1&emsp;全球市场规模

11.2.2&emsp;市场规模现状

11.2.3&emsp;市场供需分析

11.2.4&emsp;产业链的规模

11.2.5&emsp;外贸规模分析

11.3&emsp;2019-2022年中国集成电路市场竞争格局

11.3.1&emsp;进入壁垒提高

11.3.2&emsp;上游垄断加剧

11.3.3&emsp;内部竞争激烈

11.4&emsp;中国集成电路产业发展的问题及对策

11.4.1&emsp;发展面临的问题

11.4.2&emsp;发展对策分析

11.4.3&emsp;产业突破方向

11.4.4&emsp;&ldquo;十四五&rdquo;发展建议

11.5&emsp;集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

11.5.1&emsp;全球市场趋势

11.5.2&emsp;国内行业趋势

11.5.3&emsp;行业机遇分析

#### 11.5.4&emsp;市场规模预测

### 第十二章&emsp;中国芯片行业投资分析

#### 12.1&emsp;行业投资现状

##### 12.1.1&emsp;全球产业并购

##### 12.1.2&emsp;国内并购现状

##### 12.1.3&emsp;重点投资领域

#### 12.2&emsp;产业并购动态

##### 12.2.1&emsp;ARM

##### 12.2.2&emsp;Intel

##### 12.2.3&emsp;NXP

##### 12.2.4&emsp;Dialog

##### 12.2.5&emsp;Avago

##### 12.2.6&emsp;长电科技

##### 12.2.7&emsp;紫光股份

##### 12.2.8&emsp;Microsemi

##### 12.2.9&emsp;WesternDigital

##### 12.2.10&emsp;ON Semiconductor

#### 12.3&emsp;投资风险分析

##### 12.3.1&emsp;宏观经济风险

##### 12.3.2&emsp;环保相关风险

##### 12.3.3&emsp;产业结构性风险

#### 12.4&emsp;融资策略分析

##### 12.4.1&emsp;项目包装融资

##### 12.4.2&emsp;高新技术融资

##### 12.4.3&emsp;BOT项目融资

##### 12.4.4&emsp;IFC国际融资

##### 12.4.5&emsp;专项资金融资

### 第十三章&emsp;中国芯片产业未来前景展望

#### 13.1&emsp;中国芯片市场发展机遇分析

##### 13.1.1&emsp;市场机遇分析

13.1.2&emsp;国内市场前景

13.1.3&emsp;产业发展趋势

13.2&emsp;中国芯片产业细分领域前景展望

13.2.1&emsp;芯片材料

13.2.2&emsp;芯片设计

13.2.3&emsp;芯片制造

13.2.4&emsp;芯片封测

附录：

附录一：国家集成电路产业发展推进纲要

部分图表目录：

图表1&emsp;2019-2022年全球半导体市场销售规模

图表2&emsp;2019-2022年全球芯片销售规模

图表3&emsp;2022年全球IC公司市场占有率

图表4&emsp;2022年欧洲IC设计公司销售规模

图表5&emsp;2019-2022年美国半导体行业从业人员规模变动情况

图表6&emsp;2019-2022年人类每秒每\$1000成本所得到的计算能力增长曲线

图表7&emsp;28nm单个晶体管历史成本

图表8&emsp;日本综合电机企业的半导体业务重组

图表9&emsp;东芝公司半导体事业改革框架

图表10&emsp;智能制造系统架构

图表11&emsp;智能制造系统层级

图表12&emsp;MES制造执行与反馈流程

图表13&emsp;云平台体系架构

图表14&emsp;2019-2022年国内生产总值及其增长速度

图表15&emsp;2022年末人口数及其构成

图表16&emsp;2019-2022年城镇新增就业人数

图表17&emsp;2019-2022年全员劳动生产率

图表18&emsp;2022年居民消费价格月度涨跌幅度

图表19&emsp;2022年居民消费价格比2020年涨跌幅度

图表20&emsp;2022年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况

图表21&emsp;2019-2022年全国一般公共预算收入



图表22&emsp;2019-2022年末国家外汇储备

图表23&emsp;2019-2022年粮食产量

图表24&emsp;2019-2022年社会消费品零售总额

图表25&emsp;2019-2022年货物进出口总额

图表26&emsp;2022年货物进出口总额及其增长速度

图表27&emsp;2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表28&emsp;2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表29&emsp;2022年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

图表30&emsp;2022年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202304/352689.html>